

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ディービー株式会社は世界最先端の非破壊検査技術をご紹介することを目的に、東京ビッグサイトにて開催されますメンテナンス・レジリエンスTOKYO 2023に出展する運びとなりました。

また、展示会開催期間中、東京ビッグサイト会議棟にてTPAC社エンジニアが来日し技術セミナーを実施致します。本セミナーでは、世界各国の大手重電機器メーカー、航空機・航空機部品メーカー、検査・検査コンサルティング会社で実機適用がされている最先端の超音波探傷の応用技術、将来展開をご紹介致します。また、実機によるデモ実演、質疑応答を通じて、技術的な理解と交流を深めて頂ける場となっております。

ご多忙とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示会概要

<メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023・非破壊評価総合展>

日時 2023年7月26日（水）～ 7月28日（金） 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト東展示棟 東5ホール 小間番号：M5-095

最寄駅 りんかい線『国際展示場』、ゆりかもめ『東京ビッグサイト』下車 他

見どころ TPAC社製ソースコード付きサンプルソフトウェア標準付属したFMC対応フェーズドアレイ(PA)超音波探傷装置『Explorer』、マルチチャンネル超音波探傷装置『Pilot』を実機展示致します。

共催メーカー



アメリカのNDTコンサルティング、エンジニアリング会社です。特殊な超音波探傷・計測に関するアプリケーション設計、FMC/TFMコンピューティングに関するテクノロジー開発を手掛けています。PAUT、FMC/TFMの応用技術による高度なアプリケーションを製品化しています。

技術セミナー開催概要

<超音波探傷技術セミナー>

日時 2023年7月28日（金） 14:00～15:00（13:30 受付）

会場 東京ビッグサイト会議棟6F 610会議室

定員 30名

参加費 無料

■プログラム

14:00 ～ ご挨拶

14:10 ～ 『TPAC社製高度超音波探傷装置と特殊適用事例の紹介』

TPAC社では超音波探傷のグローバルな需要に答え、高度な超音波探傷装置の製品化を進めており、世界中の様々な分野における先端企業で採用されています。本セミナーでは、TPAC社製品群および特殊適用事例（探傷事例・システムインテグレート事例）の紹介を行います。また、セミナー会場では実機によるデモも行います。

キーワード：FMC/TFM, PAUT, コンベンショナルUT, 電力, 重工, 航空機, 自動車, 鉄道, 鉄鋼, ロボット, 船舶

The Phased Array Company

ハードウェア設計責任者 シュベ ジョスラン

ディービー株式会社

技術営業部 赤松 亮

※講演者及び講演内容は変更になる場合がございます。

※本セミナーは事前登録制となっております。お申込みは、お電話もしくは電子メールにてお願い致します。

TEL06-6809-3762 info@db-kk.com

※当日体調がすぐれない方のご参加はご遠慮いただきます。

お問い合わせ先

ディービー株式会社

〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前5-19河原センタービル4階

☎ 06-6809-3762

✉ info@db-kk.com

